

**IEEE International 3D Systems Integration**

**Conference 2019**

**(3DIC2019)**

**出展企業募集要項**

IEEE International 3D Systems Integration Conference 2019

組織委員長 田中 徹

(東北大学大学院医工学研究科 教授)

# I 出展企業募集のご案内

## 1. 開催概要

- (1) 名称 IEEE International 3D Systems Integration Conference 2019 (3DIC2019)
- (2) 組織委員長 田中 徹  
東北大学大学院医工学研究科 教授
- (3) 会期 2019年10月8日(火)～10月10日(木)
- (4) 日程 搬入・設置(予定) 2019年10月9日(水) 8:30～  
展示(予定) 2019年10月9日(水)～10月10日(木)  
搬出・撤去(予定) 2019年10月10日(木) 17:00～
- (5) 会場 宮城野区文化センター パトナシアター  
〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪 2-12-70  
TEL: 022-257-1213  
FAX: 022-352-6221
- (6) 参加人数 約 200 名予定

## 2. 企業展示について

- (1) 出展対象 ・電子機器 ・検査機器 ・情報機器、システム他
- (2) 出展料金

### ■企業展示

種類	単位	小間サイズ	場所	出展料金 (税別)
基礎小間	1小間	W1,800mm×D900mm ×H2,100mm	1F 展示会場	100,000 円

- (3) 募集小間数(予定) 20小間
- (4) 展示小間割の決定 事務局にて決定いたします。
- (5) 出展物  
出展対象に記載された範囲のもの、及び当方の認めたものとします。

(6) 電気

出展企業の希望により、有償で電気(交流単相二線式 100V50Hz)を開閉器にて小間まで供給します。それ以外の特殊電源に関しては別途ご相談下さい。

(7) 禁止事項

装飾物、展示物の高さは、2.1m に制限します。ただし、やむを得ず超える場合は運営事務局の承認を必要とします。また、水、プロパンガス、圧縮空気の使用、床面および壁面への直接工作(ガムテープ、アンカー等)、現金と引き換えに出展物を引き渡すことは原則的に禁止します。但し、当方の認められたものは、限定的に許可する場合があります。

(8) 外国出展物

展示場は、保税展示場にはしません。海外からの出展物は、国内貨物として出展するか、または ATA カルネの制度をご利用下さい。詳細は、運営事務局にお問い合わせ下さい。

(9) 出展企業へのご案内 開催の1ヶ月前までに小間割、搬入、装飾、管理等について詳細をご連絡いたします。

什器・照明器具等のリースにつきましてもこの時に併せてご案内いたします。

(10) 会場の管理

会場及び出展物の保全については、最善の保護と管理にあたりますが、天災その他の不可抗力による事故、盗難、紛失、及び小間内における人的被害の発生については責任を負いません。

(11) 会期・開場時間・開催場所の変更

やむを得ない事情により会期・開場時間・開催場所を変更する場合があります。

この変更を理由として出展申込を取り消すことは出来ません。

また、これによって生じた損害は補償しません。

(12) 本会議への参加資格について

出展企業に対しては講演会場へ1小間あたり2名まで参加可能です。

なお、展示会場内への入場制限はございません。

(10/8(火)に開催される基調講演の聴講も可能ですが、バンケットへの参加には別料金が必要です。)

## 1. 設置概要

### (1) 小間規格

■基礎小間(パッケージブース): 1小間=間口 1,800mm×奥行 900mm×高さ 2,100mm

・展示台 1 台 (W1,800mm×D600mm×H700mm)

白布付き(但し商品の上にかけるクロスはご持参下さい)

・バックパネル

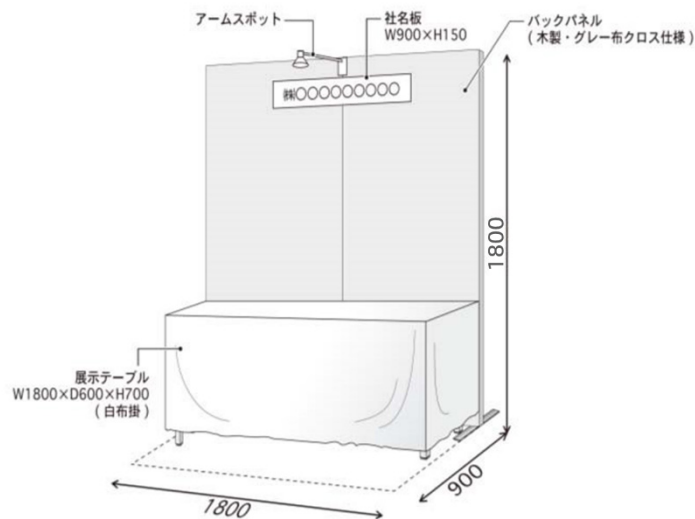
・アームスポット(1 灯)

・社名版(角ゴシック・黒文字)

・椅子(1 脚)

以上のものは運営事務局で設置いたします。上記以外の小間内装飾は、出展企業が行って下さい。

#### 基礎小間イメージ



※アームスポットは会場照明で代替する場合があります。

## 2. 出展申込

### (1) 申込み方法について

オンラインでの登録制となります。上記内容をご確認頂いた上、下記 URL より必要事項を入力の上、お申込み下さい。登録完了後、申込み内容のご確認のメールを運営事務局よりお送りさせていただきます。

お申込み多数の場合、採用企業の決定につきましては事務局一任とさせていただきますので予めご了承下さい。

申込みの締め切りにつきましては 2019 年 8 月 31 日 (金) とさせていただきます。

但し、募集小間数に達し次第、申込みを締め切らせていただきますので予めご了承下さい。

【お申込み URL】

**<https://3dic-conf.org/exhibitors>**

※アクセスに問題が生じた場合は、運営事務局までご連絡下さい。

(2) お問い合わせ・お申込みについて

出展に関するお問い合わせ・お申込みは下記にお願いいたします。

IEEE International 3D Systems Integration Conference 2019

事務局

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル 4F  
株式会社セミコンダクタポータル  
【 TEL 】 03-5733-4971  
【 FAX 】 03-5733-4973  
【 E-mail 】 3dic\_2019@semiconportal.com

(3) 出展料のお支払いについて

お申込み締め切り後、事務局より請求書をお送りいたしますので、期日までに指定口座  
(請求書に記載)にお振込み下さい。

(4) プログラム・抄録集について

出展企業には、IEEE International 3D Systems Integration Conference 2019 のプログラム・抄録集を  
1部無償で提供させていただきます。なお、完成は2019年10月中旬を予定しております。

(5) キャンセルについて

2019年9月9日(月)以降のキャンセルについては、一切お受けできません。  
キャンセルの場合は100%キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承下さい。